

高熱伝導グラファイトのパワー半導体 モジュール放熱板への適用可能性

山田 靖*, 柳瀬 匡史*, 三浦 大貴*, 竹馬 克洋**

A Study of Novel Heatsink for Power Semiconductor Modules Using High Thermal Conductive Graphite

Yasushi YAMADA*, Masashi YANASE*, Daiki MIURA* and Katsuhiko CHIKUBA**

* 大同大学 (〒 457-8530 愛知県名古屋市南区滝春町 10 番地 3)

** 株式会社サーモグラフィティクス (〒 551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾 6-2-29 テクノシーズ泉尾 405 号)

*Daido University (10-3 Takiharu-cho, Minami-ku, Nagoya-city, Aichi 457-8530)

**Thermo Graphitics Co., Ltd (TechnoSeeds Izuo 405, 6-2-29 Izuo, Taisho-ku, Osaka-city, Osaka 551-0031)